



■ 产品用途

用于智能手机的应用处理器（AP）及通信基站设备等

■ 产品特点

- 低硬度，高压缩率、低应力
- 无氧化反应、耐腐蚀
- 高模量、密度低、非氧化环境下耐超高
- 低挥发、低出油、可反复使用
- 干燥不粘腻、使用方便
- ISO认证，IATF1认证，IECQ认证

■ 产品规格

产品型号	厚度 (mm)	最大尺寸 (mm)	密度 (g/cm ³)	导热系数 (W/m·K)	耐压 (KV/mm)	硬度 (Shore OO)	工作温度 (°C)
测试标准	ASTM D374	/	ASTM D792	ASTM D5470	ASTM D149	ASTM D2240	/
BN-FS700-CF	0.3-4	60×60	2.2	7.0	< 0.1	30/50	-40~200
BN-FS1000	0.3-4	60×60	2.2	10.0	< 0.1	30/50	-40~200
BN-FS1500	0.3-4	60×60	2.4	15.0	< 0.1	60	-40~200
BN-FS2000	0.3-4	60×60	2.4	20.0	< 0.1	60	-40~200